

開示の要約

研磨方法、ワークピースの研磨監視方法および研磨監視装置

- 5 ノイズの影響を受けることなく、正確な研磨対象層の厚さを決定することができる研磨方法が開示される。本方法は、ワークピースの研磨対象層を研磨するための研磨方法であって、研磨パッドを支持する研磨テーブルを回転させ、研磨パッドにワークピースを押し付けて研磨対象層を研磨し、ワークピースに光を照射し、ワークピースからの反射光を受け、反射光の強度を波長ごとに測定し、強度と反射光の
- 10 波長との関係を示す分光波形を生成し、分光波形にフーリエ変換処理を行なって、周波数スペクトルを生成し、周波数スペクトルのピーク探索範囲を研磨時間に従って移動させ、ピーク探索範囲内にある周波数スペクトルのピークを決定し、決定されたピークに対応する前記研磨対象層の厚さを決定する。

15 図 6